

附件一、「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請表

申請編號 (請由會務處填寫)		申請日期 (西元年/月/日)	
-------------------	--	-------------------	--

一、個人基本資料：

學校名稱	(中文)		
	(英文)		
系所名稱	(中文)		
	(英文)		
申請人	(中文姓名)		(英文姓名)
身份證字號		生日	西元 年 月 日
戶籍地址			
通訊地址	(含 6 碼郵遞區號)		
電話	(市話) (手機)	Email	

二、學歷狀況：(請依最高學歷往下填寫)

學位	學校	科系	修習期間 (西元年/月~西元年/月)

三、工作經歷：(若有請填寫，並依最近工作經歷往下填寫)

任職公司	部門/職位	工作內容	任職期間 (西元年/月~西元年/月)

四、研究績效(含論文著作、專利發明、軟體、產品、產學合作、獲獎紀錄等)，依重要性排序，最多

8 項，每項扼要敘述最多 5 行。



- 1.
- 2.
- 3.
- .
- .

五、可供徵詢之專家資料

姓名	服務單位/職稱	電話(公司/手機)	Email	與申請人之關係

2

六、自傳(500 字內)

七、自述研究成果或貢獻及其重要性(500 字內，請與“四、研究績效”之項目順序相符，並可將相關項目合併陳述其整體之貢獻與重要性)

八、身份證正反面影本

身份證正面黏貼處	身份證反面黏貼處
----------	----------

九、應備文件點檢表：

項目	請打”v”	文件名稱
9-1		申請表正本(有制式表格，請向各校索取-附件一)。
9-2		推薦函正本(有制式表格，請向各校索取-附件二)。
9-3		身份證正反面影本各乙份(請貼於本申請表)。
9-4		工作服務證明正本。
9-5		取得博士學位後，參與半導體學術研究、著作論文、發明成果、獲獎紀錄、專利



		榮譽、特殊貢獻、產學合作等傑出事蹟之相關佐證資料。
9-6		請連結網址 https://forms.gle/8DjrUBtcivVgfx66 ，填寫基本資料，並將 9-1~9-5 文件掃描為單一 PDF 檔案後上傳，以利建檔。